

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2002 年 3 月 7 日 (07.03.2002)

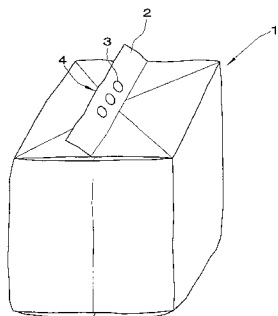
PCT

(10) 国際公開番号
WO 02/18220 A1

- (51) 国際特許分類⁷: B65D 33/08, 85/38
- (21) 国際出願番号: PCT/JP01/07227
- (22) 国際出願日: 2001 年 8 月 23 日 (23.08.2001)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2000-258517 2000 年 8 月 29 日 (29.08.2000) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 信越半
導体株式会社 (SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目4番2
号 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 好宮幹夫(YOSHIMIYA, Mikio); 〒111-0041
東京都台東区元浅草2丁目6番4号 上野三生ビル4F
Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): KR, SG, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE,
DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 外山公平
(TOYAMA, Kohei) [JP/JP]; 〒961-8061 福島県西白河
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PACKAGING BAG FOR SEMICONDUCTOR WAFER AND METHOD OF PACKAGING SEMICONDUCTOR WAFER USING THE PACKAGING BAG

(54) 発明の名称: 半導体ウエーハ用包装袋及びそれを用いた半導体ウエーハの梱包方法



(57) Abstract: A packaging bag for semiconductor wafer (1) for packaging a shipping container having semiconductor wafers stored therein, characterized in that a handle (4) is attached to the bag, wherein the handle should desirably be formed of the fused part (2) of the packaging bag and holes (3) opened in the fused part and, particularly, a plurality of circular or elliptic holes should be provided therein, whereby even a very heavy shipping container having wafers of large diameter stored therein can be stored into and retrieved from an external box, and a workability can be increased.

WO 02/18220 A1



(57) 要約:

半導体ウエーハを収容した出荷容器を包装するための袋であって、該袋に取っ手４を設けたことを特徴とする半導体ウエーハ用包装袋１。前記取っ手が、包装袋の溶着部２と該溶着部に開けた穴３からなることが好ましく、特に円形または楕円形等の穴を、複数設けることが好ましい。これにより、大口径化したウエーハを収容した高重量の出荷容器でも外装ボックスからの出し入れが容易であり、作業性を向上することができる半導体ウエーハ用包装袋が提供される。